

2011-2015年中国半导体材料行业“十二五”规划发展指导报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国半导体材料行业“十二五”规划发展指导报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xincailiao1101/X416189NHI.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2011-01-01

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国半导体材料行业“十二五”规划发展指导报告》共十二章。首先介绍了中国半导体材料行业相关概述，接着分析了中国半导体材料行业全球市场发展状况，然后对中国半导体材料行业市场运行环境及运行现状进行了重点分析，最后分析了中国半导体材料行业的发展趋势及投资前景，并提出相应投资策略。您若想对中国半导体材料行业有个系统的了解，透视行业发展现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础，本报告是您不可或缺的重要工具。

2010年是中国十一五收官之年，起草和编制下一个五年发展规划已列入今年政府工作的重要议事日程。从国务院多部门前期调研透露的信息看，未来五年中国将开启经济与社会的双重转型，以转变发展方式和调整经济结构为主线，部署中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳，从强国向富民的三大转型。

近几年我国半导体材料行业发展速度较快，受益于半导体材料行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，半导体材料行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得半导体材料行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国半导体材料行业重新迎来良好的发展机遇。进入2010年我国半导体材料行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国半导体材料行业市场竞争也日趋激烈。面对这一现状，半导体材料行业业内企业要积极应对，注重培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业竞争优势，于此同时半导体材料行业内企业还应全面把握该行业的市场运行态势，不断学习该行业最新生产技术，了解该行业国家政策法规走向，掌握同行业竞争对手的发展动态，只有如此才能使企业充分了解该行业的发展动态及自身在行业中所处地位，并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。

第一章 半导体材料行业相关概述

第一节 半导体材料行业发展情况

一、半导体材料定义

二、半导体材料行业发展历程

第二节 半导体材料产业链分析

一、产业链模型介绍

二、半导体材料产业链模型分析

第三节 2008-2010年中国半导体材料行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒 / 退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、当前行业发展所属周期阶段的判断

第二章 “十一五”期间半导体材料行业全球发展状况分析

第一节 全球半导体材料市场发展情况分析

一、2009年全球半导体材料市场发展分析

二、2009年全球半导体材料市场统计分析

三、2010年全球半导体材料市场发展分析

四、2010年全球半导体材料销售排名分析

五、2010年全球半导体材料消费者调查分析

第二节 2010年世界主要国家半导体材料市场分析

一、2010年美国半导体材料市场现状分析

二、2010年欧洲半导体材料市场现状分析

三、2010年日本半导体材料市场现状分析

四、2010年韩国半导体材料市场现状分析

五、2010年中东与非洲半导体材料市场分析

第三章 “十一五”期间中国半导体材料行业发展环境分析

第一节 国内宏观经济情况分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2011年中国宏观经济发展预测分析

第二节 中国半导体材料行业政策环境分析

一、半导体材料行业监管体制分析

二、半导体材料行业相关政策分析

第四章 “十一五”期间我国半导体材料行业发展现状分析

第一节 半导体材料行业发展基本情况

一、我国半导体材料行业发展现状分析

二、我国半导体材料行业供需情况分析

三、我国半导体材料行业技术发展状况

第二节 我国半导体材料行业存在问题及发展限制分析

一、主要问题与发展受限

二、基本应对的策略

第五章 半导体材料行业“十一五”采购状况分析

第一节 半导体材料成本分析

一、2009-2010年原材料成本走势分析

二、2009-2010年劳动力供需及价格分析

三、2009-2010年其他方面成本走势分析

第二节 上游原材料价格与供给分析

一、主要原材料情况

二、2008-2010年主要原材料价格与供给分析

三、2011-2015年主要原材料市场变化趋势预测

第三节 半导体材料产业链的分析

一、行业集中度

二、主要环节的增值空间

三、行业进入壁垒和驱动因素

四、上下游行业影响及趋势分析

第六章 半导体材料行业“十一五”规划期间行业运行监测数据分析

第一节 2008-2010年中国半导体材料行业总体数据分析

一、2008年中国半导体材料行业全部企业数据分析

二、2009年中国半导体材料行业全部企业数据分析

三、2010年中国半导体材料行业全部企业数据分析

第二节 2008-2010年中国半导体材料行业不同规模企业数据分析

一、2008年中国半导体材料行业不同规模企业数据分析

二、2009年中国半导体材料行业不同规模企业数据分析

三、2010年中国半导体材料行业不同规模企业数据分析

第三节 2008-2010年中国半导体材料行业不同所有制企业数据分析

一、2008年中国半导体材料行业不同所有制企业数据分析

二、2009年中国半导体材料行业不同所有制企业数据分析

三、2010年中国半导体材料行业不同所有制企业数据分析

第七章 半导体材料行业“十二五”规划基本思路分析

第一节 半导体材料行业面临的主要问题

第二节 半导体材料行业面临的发展形势分析

第三节 半导体材料行业“十二五”规划基本思路及基本原则

第四节 半导体材料行业“十二五”规划主要目标及主要任务

第五节 半导体材料行业“十二五”规划保障措施分析

第八章 集团企业制定“十二五”规划指导

第一节 集团企业制定“十二五”规划主要内容

一、“十一五”战略规划回顾和效果评估

二、“十二五”规划编制的指导思想和发展思路

三、“十二五”规划编制的基本出发点

四、“十二五”规划编制的流程

五、“十二五”规划编制的基础和方法

六、“十二五”规划编制的成果体现

七、“十二五”规划编制的内容

第二节 制订战略规划后的战略管理

一、战略规划的质询、批准与公布

二、战略规划的执行

三、战略执行效果的评估

四、战略检讨与调整

第九章 半导体材料行业“十二五”区域竞争格局研究

第一节 “十二五”半导体材料行业区域格局变化预测

第二节 半导体材料行业重点区域市场研究

一、重点区域市场发展现状

二、重点区域市场未来演变趋势

第三节 半导体材料行业“十二五”潜在兼并及重组机会预测

一、行业兼并重组趋势

二、主要企业及地区兼并重组动向预测

第十章 半导体材料行业“十二五”规划期重点企业竞争力分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第二节 天津中环半导体股份有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第三节 峨嵋半导体材料厂

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第四节 四川新光硅业科技有限责任公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第五节 洛阳中硅高科技有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第六节 宁波立立电子股份有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第七节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第八节 南京国盛电子有限公司

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、市场定位情况

三、市场占有份额情况

四、2009-2010年产能及占比

五、2009-2010年主要经营数据指标

六、2011-2015年公司发展战略分析

第十一章 半导体材料行业“十二五”投资方向与风险分析

第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析

第二节 产业发展的空白点分析

第三节 投资回报率比较高的投资方向

第四节 半导体材料行业投资潜力与机会

第五节 新进入者应注意的障碍因素

第六节 2011-2015年中国半导体材料行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、外资进入现状及对未来市场的威胁

第十二章 半导体材料行业“十二五”重点项目及投资机会研究

第一节 半导体材料行业“十二五”规划重大项目情况

第二节 半导体材料行业“十二五”发展趋势分析

一、技术发展预测研究

二、市场发展预测研究

第三节 半导体材料行业“十二五”投资重点分析

第四节 半导体材料行业“十二五”投资机会分析

第五节 半导体材料行业“十二五”投资策略研究

图表目录（部分）：

图表：2005-2010年上半年国内生产总值

图表：2005-2010年上半年居民消费价格涨跌幅度

图表：2010年上半年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2010年上半年年末国家外汇储备

图表：2005-2010年上半年财政收入

图表：2005-2010年上半年全社会固定资产投资

图表：2010年上半年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2010年上半年固定资产投资新增主要生产能力

图表：……

更多图表详见正文……

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xincailiao1101/X416189NHI.html>